

STANDARDLAGENAUFBAU HDI										
HDI10_1+8+1_1,50_17.5			10 - Lagen							
			Kerne: 0,20 mm Cu 17.5/17.5 µm							
WE-Artikel Nr.:					1 + 8 + 1					
KUNDE:										
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG	
KUNDE	WE							[µm]	[µm]	
1	TOP/VS				Folie	12 µm	¹⁾	12		
2	2					17.5 µm		16	1 x 1080	66
3	3				0,200 mm			200		
4	4					17.5 µm		16	2 x 1080	134
5	5				0,200 mm			200		
6	6					17.5 µm		16	2 x 1080	134
7	7				0,200 mm			200		
8	8					17.5 µm		16	2 x 1080	134
9	9				0,200 mm			200		
10	BOT/RS	Folie	12 µm	¹⁾	12	1 x 1080	66			
					1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm					
					Gesamtdicke Material:			1486		
					Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)					
MATERIALDICKE:		1,50	+/-	0,11	mm	Datum:		Bearbeiter:		
DICKE über galv. Endoberfläche		1,59	+/-	0,14	mm					
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,65	+/-	0,16	mm					
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:				
Erstellt am			Geprüft am			Freigegeben am			Revision	
27.03.2006			04.05.2006			04.05.2006			00	
S. Keller			M.Kress			R. Schönholz			Seite: 4+	